

# 石岩街道COB邦定加工设计DIP后焊

产品名称	石岩街道COB邦定加工设计DIP后焊
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

## 产品详情

来看看PCBA加工过程如何控制品质？PCBA加工过程涉及的环节比较多，一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品，一般的PCBA是由：PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列制程，下面我们详细说明一下每一个环节需要注意的地方。

### 1、PCB电路板制造

接到PCBA的订单后，分析，注意PCB的孔间距与板的承载力关系，切勿造成折弯或者断裂，布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。

就这样品质说RD没有要求厂商将保质期写入承认书，RD说厂商一般都不会写这样的信息，如有需要请采购沟通。扯皮和捣糨糊永远是需要学会的技术！下面我们就进入正题，为这位SQE朋友找出公正的裁判员。

一开始，先跟大家分享一下，其实针对电子元器件的储存，运输是有相应的标准的。国际上IEC和国内的GB/T都有定义，先把原始标准文件分享出来

PS:GB/T的标准内容相对比较滞后，如果大家需要应用的实际工作中还是需要参照IEC的标准，从搜集信息的结果看GB/T目前还是2003版本参考IEC的版本更离谱到1998版，而IEC的标准目前已经到了2007版了，大家可以将这两份文件都存起来，便于对比理解。

什么是直插DIP？直插DIP，是dual inline-pin package的缩写，也叫双列直插式封装技术，双入线封装，DRAM的一种元件封装形式。指采用双列直插形式封装的集成电路芯片，绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式，其引脚数一般不超过100。DIP封装、芯片封装基本都采用DIP(Dual In-line Package，双列直插式封装)封装

，此封装形式在当时具有适合 PCB(印刷电路板)穿孔安装，布线和操作较为方便，适合在 PCB(印刷电路板)上穿孔焊接，操作方便。芯片面积与封装面积之间的比值较大，故体积也较大。但是由于其封装面积和厚度都比较大，而且引脚在插拔过程中很容易被损坏，可靠性较差。DIP 封装的结构形式多种多样，包括多层陶瓷双列直插式 DIP，单层陶瓷双列直插式 DIP，COB邦定加工设计，引线框架式 DIP 等。但 DIP 封装形式封装效率是很低的，其芯片面积和封装面积之比为 1：1.86，这样封装产品的面积较大，内存条 PCB 板的面积是固定的，封装面积越大在内存上安装芯片的数量就越少，内存条容量也就越小。同时较大的封装面积对内存频率、传输速率、电器性能的提升都有影响。理想状态下芯片面积和封装面积之比为 1：1 将是较好的，但这是无法实现的，除非不进行封装，但随着封装技术的发展，这个比值日益接近，现在已经有了 1：1.14 的内存封装技术。什么是表贴 SMD？表贴也叫做 SMT，是 Surface Mounted Technology 的缩写，表面贴装技术，将 SMD 封装的灯用过焊接工艺焊接在 PCB 板的表面，灯脚不用穿过 PCB 板。SMD：它是 Surface Mounted Devices 的缩写，意为：表面贴装器件，它是 SMT(Surface Mount Technology 中文：表面黏著技术)元器件中的一种。

优势：组装密度高、电子产品体积小、重量轻，易于实现自动化，电子产业流行生产方式，有力减低成本，

可靠性高、抗振能力强提高产品可靠性。特点：微型 SMD 是一种晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)，它有如下特点：封装尺寸与裸片尺寸大小一致；小的 I/O 管脚；无需底部填充材料；连线间距为 0.5mm；在芯片与 PCB 间无需转接板。

石岩街道 COB 邦定加工设计 DIP 后焊由深圳市恒域新和电子有限公司提供。深圳市恒域新和电子有限公司 (www.hyxinhe.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！